

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025年5月13日业绩说明会)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	通过线上方式参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者
活动时间	2025 年 5 月 13 日（周二）10:00-11:00
活动地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	蒋学明先生（董事长） 谢莺霞女士（董事、总经理） 蒋雨舟女士（董事、副总经理、董事会秘书） 孙馨女士（财务总监） 陈丽萍女士（独立董事）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2025 年 5 月 13 日 10:00-11:00, 公司在上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/) 召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。公司管理层与投资者进行了线上交流，具体情况如下：</p> <p>1、请问公司 2025 年 Q1 产能利用率如何？未来是否有扩产计划？ 答：尊敬的投资者您好，东芯股份作为一家存储芯片设计企业，公司高度重视建立稳定可靠的供应链体系，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了互助、互利、互信的合作关系，构建了“本土深度、全球广度”的供应链网络。公司通过建立稳定战略合作并签订长期协议等方式，深化上下游合作，为业务发展提供产能保障。感谢您对我司的关注！</p> <p>2、当前存储芯片行业价格战激烈，东芯如何应对国际巨头及国内厂商的竞争？ 答：尊敬的投资者您好，市场竞争方面我们看到海外大厂正在逐步退出利基型存储芯片市场，为国内厂商带来了更多的市场空间；另一方面，国产替代的需求也将带来更多的市场机会。对东芯来说，公司将继续保持高水平的研发投入，不断推陈出新，及时迭代提升产品关键性能，以</p>

高性能、高可靠、低功耗的产品更好地满足客户的需求，巩固技术领域的“护城河”；公司将继续微缩产品制程，继续推进先进制程 1xnm SLC NAND 的量产进程，通过工艺优化与规模效应降低单位成本；公司将继续提升产品可靠性指标，强化车规级认证布局，切入汽车电子等高附加值市场，提升产品毛利水平；此外，公司将以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，依托公司现有存储芯片技术积累，在通信芯片及计算芯片领域进行突破，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。感谢您对我司的关注！

3、公司各存储新产品的研发进度如何？

答：尊敬的投资者您好，存储板块方面，公司深化存储技术布局，持续丰富产品矩阵。公司继续加强 SLC NAND Flash 技术优势，积极推进存储产品的升级迭代，“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已进入风险量产阶段，2xnm 制程持续进行 SLC NAND Flash 产品系列的研发迭代，不断扩充产品料号；公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-2Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配，并不断扩充下游终端领域；DRAM 方面，公司在已量产的 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、PSRAM 等产品基础上，持续进行新产品的研发，公司设计研发的 LPDDR4x 产品已进入量产阶段，覆盖了从消费电子到工业/汽车电子的多元化场景，其技术优势在移动设备轻薄化、工业场景可靠性及 AIoT 数据处理需求中尤为突出；MCP 方面，公司目前已可以向客户提供 4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 等组合的 MCP 产品，主要应用于 5G 通讯模块、车载模块等应用领域，公司正在研发更多容量组合的 MCP 产品，以便为客户提供更多样化的产品选择；公司在汽车领域积极进行车规客户的导入和验证，新增完成国内多家整车厂的白名单导入，完成多家境内外一级汽车供应商（Tier1）的供应商资质导入，并已向包括境外知名的一级汽车供应商（Tier1）等进行车规产品的销售。感谢您对我司的关注！

4、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，2024 年，公司所处的半导体设计行业景气度回升，网络通信、消费电子等下游市场需求有所回暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售。公司持续布局网络通信、监控安防、消费电子、工业控制等关键应用，并逐步向汽车电子领域不断拓展，立足头部客户并不断开拓新的客户。报告期内公司实现营业收入 6.41 亿元，同比增加 20.80%；营业利润-1.69 亿元，亏损收窄 51.93%；归属于母公司所有者的净利润-1.67 亿元，亏损收窄 45.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2.01 亿元，亏损收窄 38.65%。2024 年公司产品销售数量与上年同期实现较大增长，且各季度营业收入均实现环比增长。同时公司持续优化产品结构和市场策略，提升运营效率，降低产品成本，毛利率与去年同期相比有所提升。2025 年一季度公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，持续布局网络通信、监控安防、消费电子、工业控制、汽车电子等关键应用，有效推动了产

品销售。2025 年一季度，公司产品销售数量较上年同期相比显著增长，实现营业收入 1.42 亿元，同比增加 33.90%。归属于母公司股东的净利润为-5,924.18 万元，较上年同期增加 33.11%（以绝对值计算），主要受到研发费用增长、财务费用增长以及对外投资亏损的影响。感谢您对我司的关注！

5、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，公司致力于通过自主研发的知识产权、稳定的供应链体系以及高可靠性产品，为客户提供优质的存储产品及解决方案。公司以存储为核心，同时在“存、算、联”一体化领域进行技术创新，拓展行业应用范围，优化业务布局，旨在为客户提供多样化的芯片解决方案。在存储芯片领域，公司通过制程推进，产品结构布局不断完善，提升产品核心竞争力，为网络通信、监控安防、消费电子、工业控制、汽车电子等应用领域提供多样化的存储产品解决方案，以期在利基型存储板块获取更多市场份额。随着海外厂商退出利基市场，公司在相关领域的市占率有望持续提升；另一方面，随着 AI 技术革命加速，边缘计算设备催生对中小容量、高可靠性存储芯片的需求增长，有望给公司带来更多的市场空间。在联接芯片领域，公司于报告期内设立子公司亿芯通感，开展 Wi-Fi7 无线通信芯片的研发设计。首款无线透传芯片聚焦高带宽、低时延场景，可满足智能终端等领域对高速连接的需求，通过差异化创新为消费类企业客户提供本土化的智能无线通信与感知的芯片及解决方案，目前项目进展顺利。在计算芯片领域，公司于 2024 年通过自有资金 2 亿元人民币战略投资上海砺算，布局高性能 GPU 赛道。上海砺算坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和 AI 加速，对标主流 GPU 架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整 GPU 架构自主可控的关键问题。我们相信随着公司“存、算、联”技术生态的不断完善，将逐步提升公司盈利能力。感谢您对我司的关注！

6、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢

答：尊敬的投资者您好，依据 WSTS 的 2024 年秋季预测数据，2024 年全球半导体市场规模约为 6,268.69 亿美元，同比增长 19.0%，其中存储芯片市场规模约为 1,670.53 亿美元，同比增长 81%；预计未来市场将继续呈增长态势，预计 2025 年全球半导体市场规模约为 6,971.84 亿美元，同比增长 11.2%，预计 2025 年存储芯片市场规模为 1,894.07 亿美元，同比增长 13.4%。行业内其他主要企业的业绩表现您可以关注其公司的定期报告，感谢您对我司的关注！

7、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，当前全球存储芯片市场仍由三星、SK 海力士、美光、铠侠等国际巨头主导，占据了大部分市场份额，而国内厂商正通过差异化策略在利基型存储市场实现突围，通过快速响应客户需求、提供本地化技术服务等建立竞争优势。在当前复杂多变的国际形势下，国内厂商正积极响应国产替代的需求，努力实现中国存储芯片的自主研发。

	<p>另一方面，随着 AI 技术革命加速，存储芯片市场正经历结构性变革。AI 服务器对高带宽内存（HBM）需求激增，推动 DRAM 产品结构向高端迁移；智能汽车自动驾驶系统存储需求较传统车型呈指数级增长；边缘计算设备催生对中小容量、高可靠性存储芯片的需求增长。未来，随着全产业链技术的不断突破与生态系统的构建完善，国内存储产业正努力逐步从低端替代向高端引领进行转变，国产存储芯片的发展前景值得期待。感谢您对我司的关注！</p>
日期	2025 年 5 月 13 日